(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年9月18日(18.09.2025)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2025/192663 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 23/28 (2006.01) *H01L 21/56* (2006.01)

(21) 国際出願番号： PCT/JP2025/009413

(22) 国際出願日： 2025年3月12日(12.03.2025)

(25) 国際出願の言語： 日本語

(26) 国際公開の言語： 日本語

(30) 優先権データ：
特願 2024-041000 2024年3月15日(15.03.2024) JP

(71) 出願人: 株式会社レゾナック (**RESONAC CORPORATION**) [JP/JP]; 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目９番１号 (JP).

(72) 発明者: 武笠 真之介 (**TAKEGASA Shinnosuke**); 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目９番１号 株式会社レゾナック内 (JP).

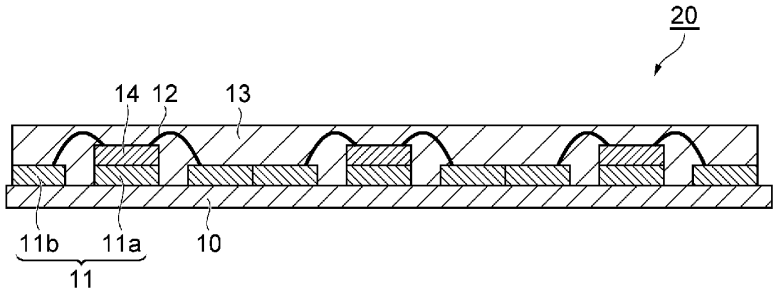
(74) 代理人: 長谷川 芳樹，外 (**HASEGAWA Yoshiki** et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 丸の内ＭＹ ＰＬＡＺＡ（明治安田生命ビル） ９階 創英国際特許法律事務所 (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU,

(54) **Title:** TEMPORARY PROTECTION FILM FOR SEMICONDUCTOR ENCAPSULATION MOLDING, METHOD FOR MANUFACTURING SAME, LEAD FRAME PROVIDED WITH TEMPORARY PROTECTION FILM, TEMPORARILY PROTECTED ENCAPSULATION MOLDING OBJECT, AND METHOD FOR MANUFACTURING SEMICONDUCTOR PACKAGE

(54) 発明の名称： 半導体封止成形用仮保護フィルム及びその製造方法、仮保護フィルム付きリードフレーム、仮保護された封止成形体、並びに、半導体パッケージを製造する方法



(57) **Abstract:** This temporary protective film for semiconductor encapsulation molding comprises a support film, and an adhesive layer that is provided on one surface or both surfaces of the support film, the temporary protective film being used for temporarily protecting a surface of a lead frame on the opposite side from a semiconductor element that is mounted on a die pad of the lead frame during encapsulation molding for forming an encapsulation layer that encapsulates the semiconductor element. The adhesive layer contains a thermoplastic resin and a low-molecular-weight component that is a compound having a molecular weight of less than 1000. The total chlorine content in the low-molecular-weight component is 12.5 mass% or more.

WO 2025/192663 A1

［続葉有］

TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

一　国際調査報告（条約第21条(3)）

(57) 要約：支持フィルムと、支持フィルムの片面又は両面上に設けられた接着層と、を備え、リードフレームのダイパッドに搭載された半導体素子を封止する封止層を形成する封止成形の間、リードフレームの半導体素子とは反対側の面を仮保護するために用いられる、半導体封止成形用仮保護フィルム。接着層が、熱可塑性樹脂と、分子量１０００未満の化合物である低分子成分と、を含む。低分子成分における全塩素量が１２．５質量％以上である。